

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第3区分

【発行日】平成24年4月12日(2012.4.12)

【公開番号】特開2009-207142(P2009-207142A)

【公開日】平成21年9月10日(2009.9.10)

【年通号数】公開・登録公報2009-036

【出願番号】特願2009-39050(P2009-39050)

【国際特許分類】

H 01 P	1/04	(2006.01)
H 01 P	5/02	(2006.01)
H 05 K	1/14	(2006.01)
H 01 R	12/79	(2011.01)
H 01 R	12/78	(2011.01)
H 01 R	12/71	(2011.01)

【F I】

H 01 P	1/04	
H 01 P	5/02	6 0 3 E
H 05 K	1/14	D
H 01 R	23/68	3 0 3 G

【手続補正書】

【提出日】平成24年2月23日(2012.2.23)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

少なくとも1つの第1の伝送ライン、および、前記第1のラインの一つの先端にある少なくとも1つの金属ホールを含む第1の基板上の相互接続手段であって、前記金属ホールは、前記基板の2つの面上で非金属化されたセーピングにより囲まれており、前記金属ホールと前記伝送ライン部分に関連する前記第1の基板の接地面との間に形成された前記セーピングは、第1のフィルタ素子を形成する、相互接続手段。

【請求項2】

前記フィルタ素子の回路網は、自己インダクタンス素子および並列の共振素子によって構成され、低域通過型応答を示す、請求項1に記載の相互接続手段。

【請求項3】

前記共振素子の値は、前記金属ホールと前記第1の基板の前記接地面との間の前記セーピングの大きさの関数である、請求項2に記載の相互接続手段。

【請求項4】

前記誘導素子の値は、前記セーピング上の前記伝送ラインの大きさの関数である、請求項2に記載の相互接続手段。

【請求項5】

前記第1の基板の前記伝送ラインは、ライン素子により前記金属ホールを越えて延びている、

請求項 1 ないし 4 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 6】

第 2 の基板上にある第 2 の伝送ラインを延設する突出部が前記金属ホールへ挿入され、前記突出部は、伝送ライン部分、および、接地セーピングを含む、

請求項 1 ないし 5 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 7】

前記第 2 の基板の前記伝送ライン部分は、前記金属ホールに挿入され、かつ、その反対側の接地セーピングは、追加のフィルタ素子を形成する、

請求項 6 に記載の相互接続手段。

【請求項 8】

前記追加のフィルタ素子は、自己インダクタンス素子である、

請求項 7 に記載の相互接続手段。

【請求項 9】

前記誘導素子の値は、前記セーピング上の前記伝送ラインの長さの関数である、

請求項 8 に記載の相互接続手段。

【請求項 10】

前記第 2 の基板の前記突出部の部分は、第 2 の供給ラインを受け入れる面の反対側の面上で非金属化されている、

請求項 6 ないし 9 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 11】

前記第 1 および第 2 の伝送ラインは、マイクロストリップ・ライン、コプラナー・ライン、または、プレート・ラインである、

請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。

【請求項 12】

前記第 1 および第 2 の基板は、単一層または多層基板である、

請求項 1 ないし 10 のいずれか 1 項に記載の相互接続手段。